

株主メモ (平成15年3月31日現在)

決算期	3月31日
定時株主総会	毎年6月
基準日	3月31日
株主確定	3月31日
利益配当金	3月31日
1単元の株式数	100株
名義書換代理人	大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番4号 住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付および 電話照会先	〒183-8701東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部
(住所変更など用紙のご請求)	☎ 0120-175-417
(その他のご照会)	☎ 0120-176-417
同 取 次 所	住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店
公 告 掲 載 紙	日本経済新聞

FAX送信サービス

株主・投資家のみなさまに、会社案内・決算短信・事業報告書・製品紹介パンフレット・ニュースリリースなどをご要望に応じて提供しております。

FAX送信サービス FAX 03-3281-8078

お問い合わせは 総務部 広報課 TEL 03-3281-8186
FAX 03-3281-8160

FerroTec

株式会社 フェローテック

〒104-0031 東京都中央区京橋1-4-14
TEL 03-3281-8808 FAX 03-3281-8848
URL <http://www.ferrotec.co.jp/>

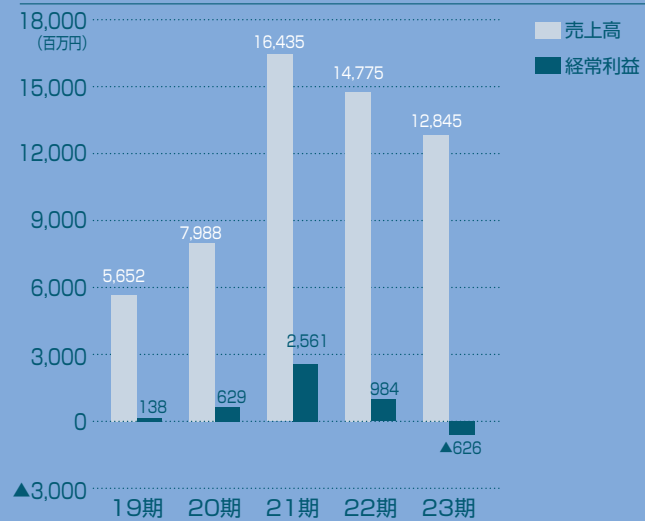


FerroTec
株式会社 フェローテック

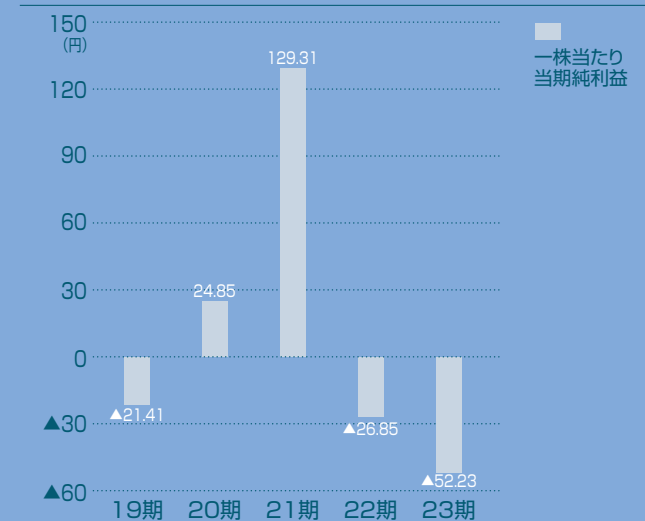
第23期
事業報告書

平成14年4月1日～平成15年3月31日

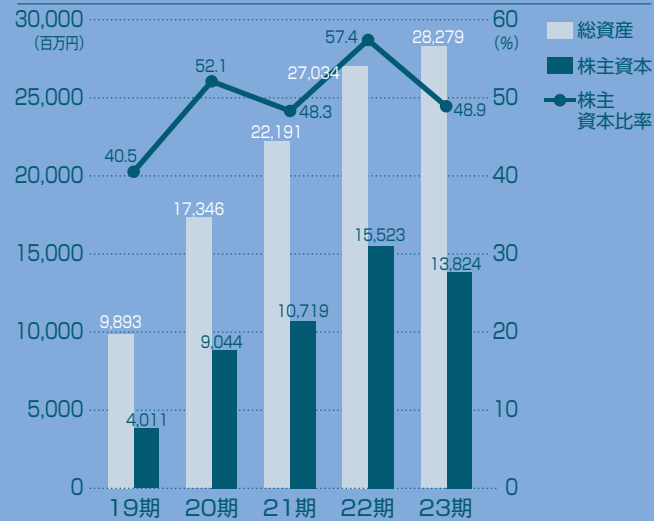
売上高・経常利益



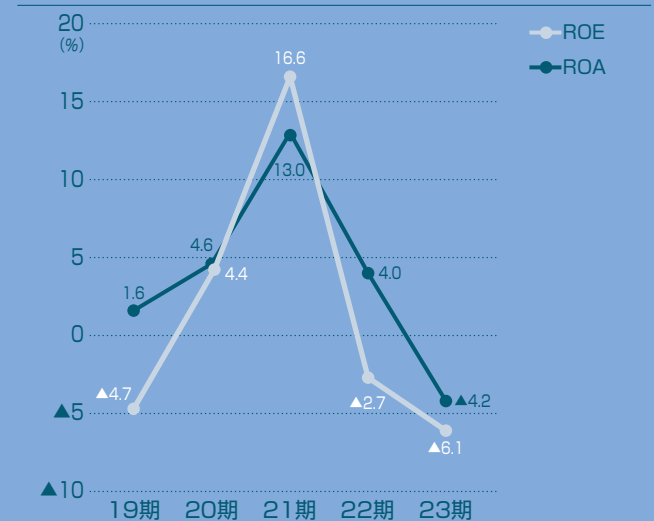
一株当たり当期純利益



総資産・株主資本・株主資本比率



ROE (株主資本利益率)・ROA (総資産利益率)



事業の合理化・効率化と
新たな収益基盤の確立に向け
成長分野に経営資源を集中していきます。

代表取締役社長 山村 章

株主のみなさまには、益々清栄のこととお慶び申し上げます。当社第23期の事業報告書をお届けするにあたり、一言ごあいさつを申し上げます。

当社グループが、事業展開する半導体・エレクトロニクスなどのハイテク産業分野における経済環境は、生産調整や設備投資の抑制が続き、先行きは不透明なものとなっております。また、わが国においても個人消費は冷え込み、景気回復の兆しは見えておりません。

このような状況のもと、当社グループでは、ものづくりの要素技術を拡充し、世界のあらゆる市場で高い競争力を発揮する製品を送り出すグローバル製造業を目指しております。装置関連事業では、コスト競争力の強化を図り、石英製造および基板実装ラインの中国子会社への移管と生産技術移転を推進いたしました。また、次代の中核事業として期待するCMS事業では、中国での「シリコンウェハー事業」「リチウムイオン二次電

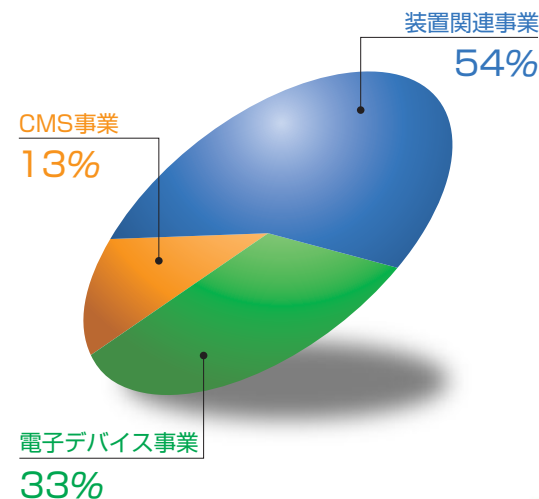
池事業」など、新機軸となる新たなビジネスモデルの構築に努めました。さらに、電子デバイス事業では、自動車シート用サーモモジュールや新型磁性流体軸受『FFB』の開発など、戦略商品を中核に新たな事業展開を推進いたしました。このように、当期においても積極的な事業活動を行ってまいりましたが、連結業績は、売上高12,845百万円（前期比13.1%減）、営業利益111百万円（同87.8%減）、当期純利益△899百万円となりました。

来期に向けては中国子会社を製造拠点だけでなく販売拠点として拡充するとともに、日米からの生産移管や米国子会社を通じた欧米への製品供給をさらに拡大するなど、成長分野への経営資源の集中と積極的な先行投資、生産体制の合理化・効率化を強力に推進する考えです。

今後とも、業績向上のため一層努力してまいります。株主のみなさまには、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

セグメント別営業概況

当社では、これまでコアテクノロジーである「磁性流体技術」を利用しているかどうかによる事業セグメントを採用していましたが、当期より「装置関連事業」「電子デバイス事業」「CMS事業」という製品用途・市場分野に応じた3つの事業セグメントに変更しています。ここでは、各セグメントの概要と当期の概況についてご報告します。



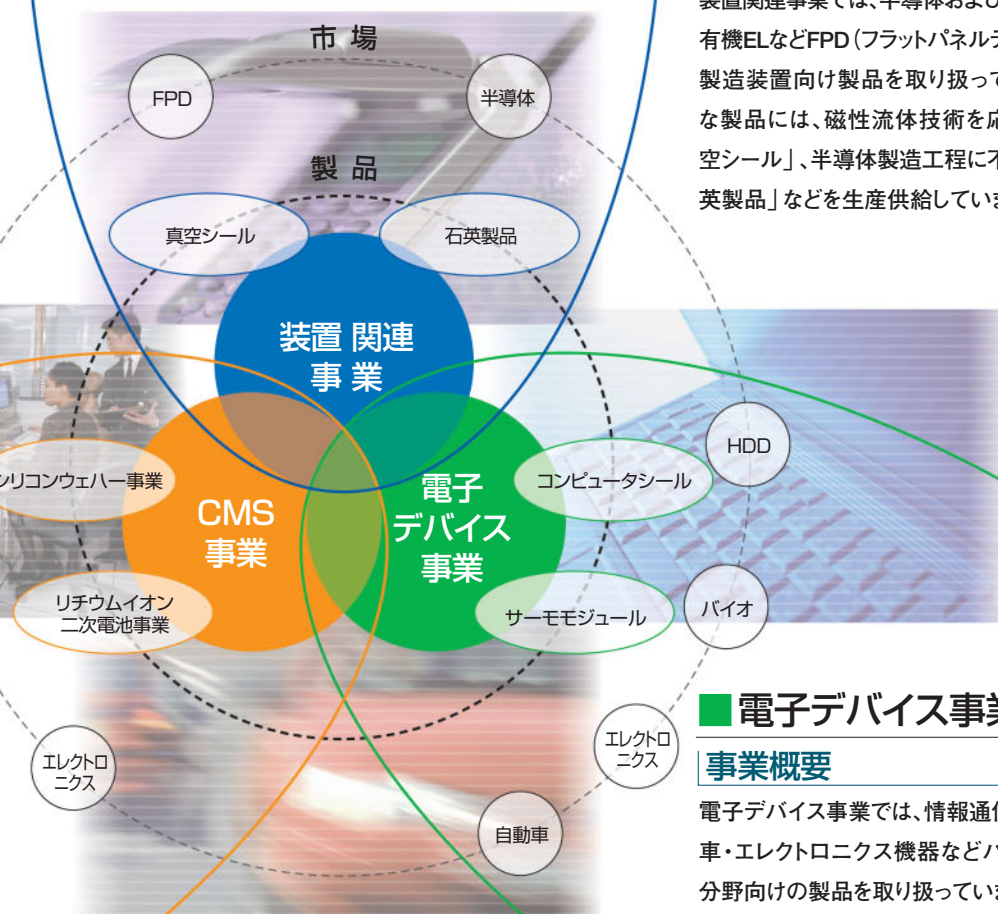
■ CMS (コントラクトマニュファクチャリングサービス) 事業

事業概要

CMS事業は、当社の中国における生産能力、オペレーションノウハウを活かした受託生産事業です。当社の生産対応力とパートナー企業がつ優位性のある技術を融合することで、グローバル市場において競争力をもった製品を創出する新たなビジネスモデルの構築に努めています。

当期の概況

受託製造製品は多岐にわたり、また顧客との守秘義務もあるため、詳細な情報開示はしていませんが、開示可能な受託品にはシリコンウェハー加工・工作機械組立・装置部品の洗浄などがあります。これら新事業は、立ち上げて間もないものが多いため、売上高は1,722百万円(前期比156.9%増)、営業利益は△266百万円となりました。



■ 装置関連事業

事業概要

装置関連事業では、半導体および液晶・PDP・有機ELなどFPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置向け製品を取り扱っています。主な製品には、磁性流体技術を応用した「真空シール」、半導体製造工程に不可欠な「石英製品」などを生産供給しています。

当期の概況

「真空シール」は、半導体製造装置の投資抑制の影響を受けたものの、FPD製造装置向け製品の販売は堅調で、ほぼ計画通りとなりました。一方、「石英製品」は、国内半導体メーカーが主な供給先であるため、需要が著しく低下しました。その結果、売上高は6,851百万円(前期比24.8%減)、営業利益は△87百万円となりました。



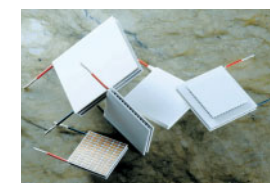
■ 電子デバイス事業

事業概要

電子デバイス事業では、情報通信機器・自動車・エレクトロニクス機器などハイテク産業分野向けの製品を取り扱っています。主な製品としては、HDD(ハードディスクドライブ)向け部品「コンピュータシール」や情報通信・エレクトロニクス・バイオなど幅広い分野で活用される冷熱素子「サーモモジュール」、当社のコアテクノロジーでもある「磁性流体」などを生産供給しています。

当期の概況

「コンピュータシール」は、HDDの低価格化による使用機種数の減少やサーバー用HDDの生産調整、次世代HDDの生産延期もあり計画を下回りました。「サーモモジュール」は、半導体製造装置向けおよび民生向け製品が減少しましたが、自動車用温調シート向けが好調でほぼ計画通りでした。その結果、売上高は4,274百万円(前期比14.3%減)、営業利益は501百万円(同1.8%増)となりました。



フェローテックは今 新たな成長段階に入ろうとしている。

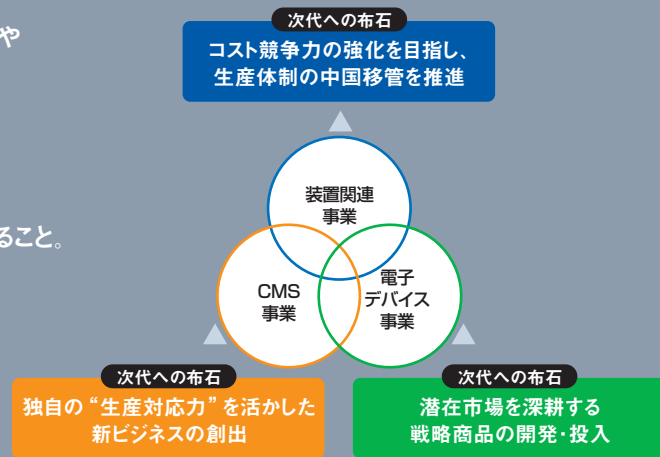
代表取締役社長

山村 章

akira yamamura

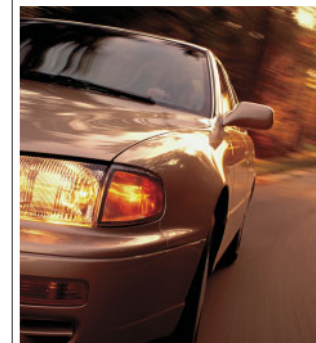


1980年、磁性流体の輸入販売会社として誕生した当社は、磁性流体技術を応用した「コンピュータシール」「真空シール」やハイテク産業向け冷熱素子「サーモモジュール」などユニークな機能製品を開発・製造することで企業としての成長を果たしてきました。市場の変化を捉え、可能性を秘めた技術シーズに着目し、迅速に製品化・量産化することで圧倒的な市場シェアを獲得すること。これが当社を成長させたビジネスモデルであったと言えます。そして現在、当社では市場環境の変化を見据え、新たな収益基盤の確立に向けた取り組みを推進しています。その「足場固め」として取り組んだ当期の施策に込められた「意図とねらい」について、山村社長に語っていただきました。



さらなる成長への布石となる “戦略商品”の開発・供給を積極化。

電子デバイス事業においては、潜在する市場ニーズに応え、今後の収益を牽引すると期待される2つの戦略商品があります。一つは自動車温度調節シート向けサーモモジュール、もう一つがハイエンドサーバ向け磁性流体動圧軸受『FFB (フルイドフィルムベアリング)』です。当社ではこの2商品を経営戦略商品として位置づけ、電子デバイス事業における中核製品としての育成を図っていきます。



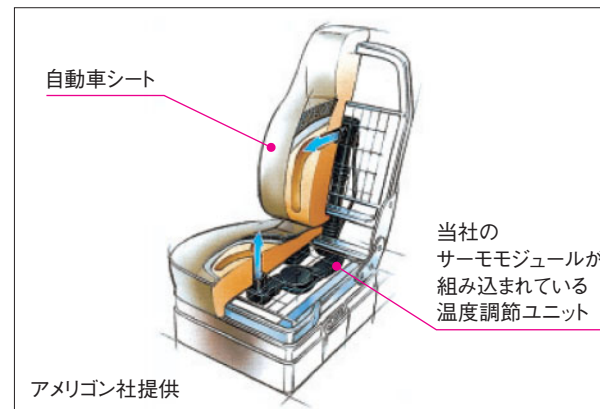
自動車温度調節シート向け サーモモジュールの需要拡大

当社のサーモモジュールは、自動車シートの温度調節ユニットとして米国自動車部品メーカーのアメリカン社で採用されています。当社独自のサーモモジュール技術を活かしたこの製品は、現在、日米の大手自動車メーカーの主要高級車種にスペックインされ始めています。自動車向けサーモモジュールのサプライヤーは、現在当社のみであり、今後、グローバルマーケットにおけるデファクトスタンダード商品となる可能性を秘めています。現在、当社では、製品の付加価値化を目指し、当社の保有する多彩な組立・加工技術を活かした、より最終製品に近い

ユニットを供給できる生産体制の整備に努めるとともに、今後のさらなる需要拡大を見据えた生産能力の増強を進めていきます。

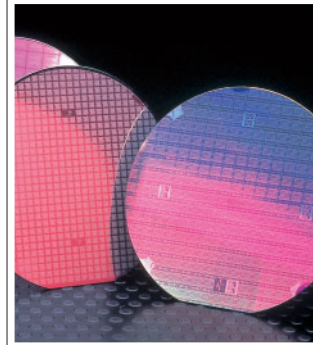
FFB (フルイドフィルムベアリング) の 研究開発を推進

情報化社会の進展とともにサーバのハイエンド化が進展しています。ハイエンドサーバ市場は、2005年には3,000万台という需要拡大が見込まれ、一層の信頼性と高機能が求められています。このような状況の下、当社では磁性流体技術を活かしたハイエンドサーバ向けの動圧軸受『FFB』の研究開発を推進しています。この製品は、従来使用されていた動圧軸受に比べ、きわめて消費電力が少なく、製品使用時の液漏れを完全に防止できるという優れた製品特性を有しています。今後、さらに高度化する顧客ニーズに応える製品として実用化・量産化が期待されており、すでに量産評価用のサンプル出荷が始まりました。



中国における“生産対応力”が新たなビジネスを創出する。

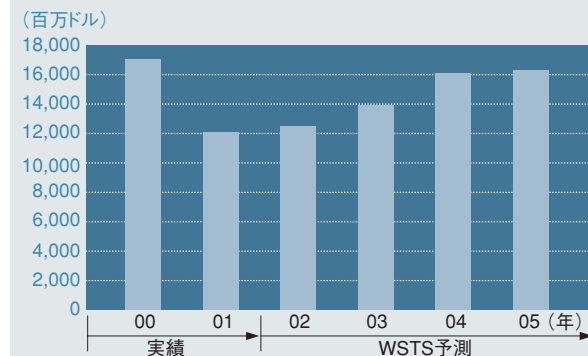
CMS (コントラクトマニュファクチャリングサービス) 事業は、パートナー企業の「高度な技術ノウハウ」と当社の強みである「中国における生産体制・オペレーションノウハウ」を融合し、“モノづくりの新しいカタチ”を創出する製造受託事業です。当社では、パートナー企業との効果的な連携により、グローバル市場で勝ち抜ける製品を供給する、新たなビジネスモデルの創出を目指しています。



本格化するシリコンウェハー事業——東芝セラミックス(株)とのパートナーシップ

当社では、中国でのシリコンウェハー事業をCMS事業における主力ビジネスと位置づけ積極的に事業展開しています。2002年3月に三井物産(株)と東芝セラミックス(株)とのパートナーシップを発表し、小口径シリコンウェハー用生産設備・加工技術を当社の上海工場へ移管し、個別半導体用小口径シリコンウェハーの加工受託を開始しました。さらに今後は、需要の伸びが予想され増量化への取り組みを含め、シリコンウェハー事業の拡大を積極化していきます。

個別半導体の市場規模

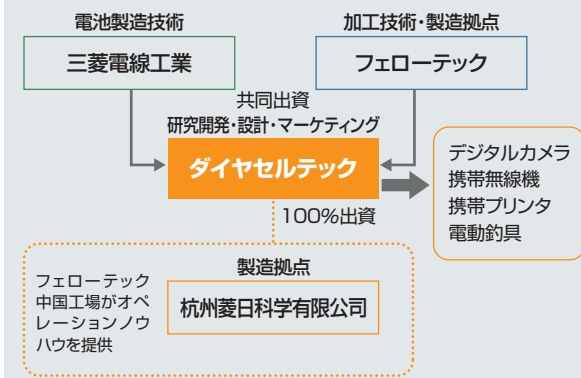


データ出典:WSTS日本協議会「WSTS2002年秋季半導体市場予測」

胎動するリチウムイオン二次電池事業——三菱電線工業(株)とのパートナーシップ

当社は、2002年10月に三菱電線工業(株)と二次電池の研究開発・設計・マーケティングを行う合弁会社ダイヤセルテック(株)を設立し、リチウムイオン二次電池事業へ参入しました。低温・大電流対応型の特殊電池製造技術に優れた三菱電線工業と中国における生産能力を有する当社とのパートナーシップにより、製品品質とコスト競争力を兼ね備えたリチウムイオン二次電池の開発と生産・供給体制をいち早く確立することで、グローバル市場におけるシェア獲得を目指しています。

リチウムイオン二次電池事業の展開



回復基調の市場を見据えて生産体制の合理化を推進。

半導体製造産業は半導体不況の影響から、設備投資が抑制されていましたが、徐々に回復の兆しを見せ始めています。一方、液晶・PDP・有機ELなどFPD(フラットパネルディスプレイ)市場は引き続き堅実な成長を見せており、今後も堅調な設備投資が見込まれています。当社では、こうした市場動向を見据え、生産・供給体制の合理化・効率化に努めています。



半導体市況の好不調の波(シリコンサイクル)に左右されない安定した収益基盤づくりを目指して

半導体製造装置市場においては、シリコンサイクルが底にある時にも利益体質を維持することが大きなテーマとなります。当社では、シリコンサイクルに左右されない合理的な事業体制の確立を目指し、生産体制の再構築を推進しています。「真空シール」「石英製品」など装置関連事業製品は、日本・米国・中国の3極体制で生産していますが、当期は、石英の国内生産ラインを杭州工場へ移管するなど、中国へのシフトを進めコスト競争力と利益体質の強化を図っています。また、半導体周辺機器・メンテナンスを含めた製品と加工技術の蓄積による製品価値の向上を図ることで、安定した収益確保を目指しています。

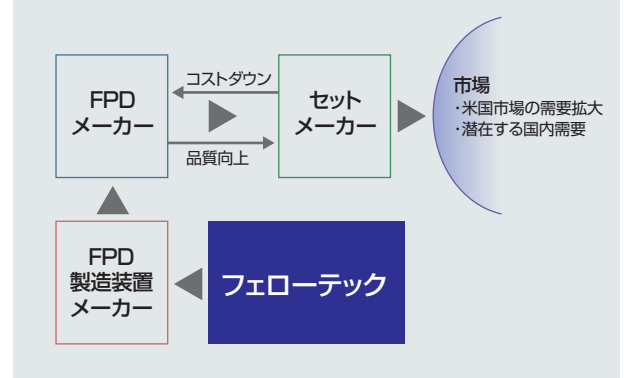


杭州大和熱磁電子有限公司

FPD市場の拡大を見据えて生産ラインの合理化とコストダウンを追求

FPD市場は今後、世界規模での需要拡大が予想されます。一般家庭向けの、PCディスプレイやハイビジョンTVなどの需要が高まりを見せており、地上デジタル放送用TVへの買い替え需要も期待されています。こうした中、FPD市場では、さらなる品質の向上とコストダウンの両立が求められており、製造装置にも同様の要求が求められています。当社では、FPD製造装置向けの真空シール生産ラインの合理化とコストダウンに努め、市場のニーズに対応していきます。

拡大が見込まれるFPDへの対応



連結財務諸表 (連結貸借対照表／連結損益計算書／連結剰余金計算書／連結キャッシュ・フロー計算書)

連結貸借対照表 (単位:千円)

科目	第23期	第22期
	平成15年3月31日現在	平成14年3月31日現在
■資産の部		
流動資産	10,543,080	10,027,166
現金及び預金	2,860,432	3,657,192
受取手形及び売掛金	3,444,918	2,714,901
たな卸資産	2,971,153	2,725,117
その他	1,374,636	1,017,492
貸倒引当金	△ 108,061	△ 87,536
固定資産	17,736,133	17,007,049
有形固定資産	11,195,370	10,455,942
建物及び構築物	3,631,548	3,477,061
機械装置及び運搬具	2,634,047	2,413,816
土地	2,673,349	2,657,299
その他	2,256,424	1,907,765
無形固定資産	2,980,228	3,332,489
営業権	1,928,806	2,044,242
連結調整勘定	488,454	705,987
その他	562,966	582,259
投資その他の資産	3,560,534	3,218,617
投資有価証券	1,273,511	1,138,070
その他	2,308,074	2,376,917
貸倒引当金	△ 21,050	△ 296,370
資産合計	28,279,213	27,034,216

●資産の部

当期末の資産合計は、前期末と比べ12億44百万円増加し282億79百万円となりました。

これは、流動資産は、中国子会社でのCMS事業のシリコンウェハー加工に係わるたな卸資産などの増加により、前期末に比べ5億15百万円増加し105億43百万円となり、固定資産は、流動資産と同様、中国子会社でのCMS事業のシリコンウェハー加工に係わる設備投資などにより、前期末に比べ7億29百万円増加し177億36百万円となったことによるものです。

連結損益計算書 (単位:千円)

科目	第23期	第22期
	平成15年3月31日現在	平成14年3月31日現在
■負債の部		
流動負債	8,624,864	5,953,532
支払手形及び買掛金	1,053,287	1,235,227
短期借入金	3,363,439	1,607,452
一年内返済予定長期借入金	2,159,249	1,471,244
その他	2,048,886	1,639,608
固定負債	5,778,388	5,152,817
社債	599,500	659,750
長期借入金	4,933,809	4,239,352
退職給付引当金	51,753	28,942
その他	193,325	224,772
負債合計	14,403,252	11,106,350
■少数株主持分	51,627	404,543
■資本の部		
資本金	5,824,907	5,822,333
資本剰余金	6,700,406	6,697,835
利益剰余金	1,075,557	2,170,498
その他有価証券評価差額金	△ 76,419	△ 78,046
為替換算調整勘定	399,485	910,829
自己株式	△ 99,605	△ 128
資本合計	13,824,332	15,523,322
負債、少数株主持分及び資本合計	28,279,213	27,034,216

(注) 1.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2.第22期における資本の部については、改正後の連結財務諸表等規則により表示しております。

●負債の部

当期末の負債合計は、前期末と比べ32億96百万円増加し144億3百万円となりました。これは主に、短期および長期借入金が増加したことによるものです。

●資本の部

当期末の資本合計は、前期末と比べ16億98百万円減少し138億24百万円となりました。これは主に、当期純損失と配当金など利益処分による利益剰余金の減少、および円高の影響で為替換算調整勘定が減少したことによるものです。

連結損益計算書 (単位:千円)

科目	第23期	第22期
	平成14年4月1日から平成15年3月31日まで	平成13年4月1日から平成14年3月31日まで
■経常損益の部		
売上高	12,845,187	14,775,891
売上原価	8,200,834	8,721,606
売上総利益	4,644,352	6,054,284
販売費及び一般管理費	4,533,036	5,138,183
営業利益	111,316	916,101
営業外収益	167,201	583,317
営業外費用	905,076	514,544
経常利益又は経常損失(△)	△ 626,559	984,874
■特別損益の部		
特別利益	162,311	121,872
特別損失	362,814	1,305,528
税金等調整前当期純損失	827,062	198,781
法人税、住民税及び事業税	118,476	264,424
法人税等調整額	△ 41,258	△ 186,512
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△ 5,141	80,311
当期純損失	899,140	357,005

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

●連結損益計算書

売上高は、世界的な電子機器産業の需要の落ち込みや設備投資抑制の影響を受け、前期に比べ19億30百万円減少し128億45百万円となりました。営業利益は売上高の減少と売上構成の変化により、前期に比べ8億4百万円減少し1億11百万円となりました。また、経常利益は、為替差損などが発生し6億26百万円の損失となり、当期純利益は投資有価証券評価損などが発生し8億99百万円の損失となりました。

連結剰余金計算書 (単位:千円)

科目	第23期	第22期
	平成14年4月1日から平成15年3月31日まで	平成13年4月1日から平成14年3月31日まで
■資本剰余金の部		
資本剰余金期首残高	6,697,835	-
資本剰余金増加高	-	-
増資による新株の発行	2,571	-
資本剰余金期末残高	6,700,406	-
■利益剰余金の部		
利益剰余金期首残高	2,170,498	2,558,267
利益剰余金増加高	-	140,907
連結子会社減少による利益剰余金増加高	-	140,907
利益剰余金減少高	1,094,940	528,677
当期純損失	899,140	357,005
連結子会社増加による利益剰余金減少高	11,724	-
配当金	172,482	135,855
役員賞与	-	35,000
その他	11,593	816
利益剰余金期末残高	1,075,557	2,170,498

(注) 1.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2.第22期については、改正後の連結財務諸表等規則により表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:千円)

科目	第23期	第22期
	平成14年4月1日から平成15年3月31日まで	平成13年4月1日から平成14年3月31日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 321,386	2,580,331
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,494,016	△ 6,745,136
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,827,027	5,050,235
現金及び現金同等物に係る換算差額	142,819	△ 31,560
現金及び現金同等物の増加額	△ 845,556	853,869
現金及び現金同等物の期首残高	3,657,192	2,812,788
連結子会社減少による現金及び現金同等物の減少額	-	△ 9,466
連結子会社増加による現金及び現金同等物の増加額	368	-
現金及び現金同等物の期末残高	2,812,004	3,657,192

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

●連結キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前損失が8億27百万円となり、3億21百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、中国子会社での設備投資を中心に34億94百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長・短借入金を中心に28億27百万円の収入となりました。その結果、現金及び現金同等物は前期より8億45百万円減少し28億12百万円となりました。

個別財務諸表 (貸借対照表／損益計算書／利益処分)

貸借対照表 (単位:千円)

科目	第23期	第22期
	平成15年3月31日現在	平成14年3月31日現在
■資産の部		
流動資産	6,459,965	5,518,793
現金及び預金	925,799	1,523,552
受取手形及び売掛金	1,708,998	1,566,467
その他	3,825,167	2,428,773
固定資産	14,619,436	13,826,953
有形固定資産	3,095,894	3,144,566
建物	606,202	648,047
土地	2,240,985	2,240,985
その他	248,706	255,533
無形固定資産	17,952	16,520
投資その他の資産	11,505,588	10,665,866
関係会社株式・出資金	7,696,958	5,850,873
その他	3,808,630	4,814,993
資産合計	21,079,402	19,345,746

(単位:千円)

科目	第23期	第22期
	平成15年3月31日現在	平成14年3月31日現在
■負債の部		
流動負債	4,431,937	3,192,000
支払手形及び買掛金	796,702	725,617
その他	3,635,235	2,466,383
固定負債	3,632,622	2,801,947
長期借入金	3,513,256	2,685,820
その他	119,366	116,127
負債合計	8,064,559	5,993,947
■資本の部		
資本金	5,824,907	5,822,333
資本剰余金	6,461,394	6,458,823
利益剰余金	901,305	1,149,281
うち当期末処分利益	328,483	75,287
その他有価証券評価差額金	△ 73,161	△ 78,511
自己株式	△ 99,605	△ 128
資本合計	13,014,842	13,351,799
負債・資本合計	21,079,402	19,345,746

(注) 1.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2.第22期における資本の部については、改正後の財務諸表等規則により表示しております。

損益計算書 (単位:千円)

科目	第23期	第22期
	平成14年4月1日から平成15年3月31日まで	平成13年4月1日から平成14年3月31日まで
売上高	5,225,073	6,517,743
売上原価	3,007,554	4,142,163
売上総利益	2,217,518	2,375,580
販売費及び一般管理費	2,296,379	2,306,674
営業利益又は営業損失(△)	△ 78,861	68,905
営業外収益	473,273	519,537
営業外費用	321,442	293,112
経常利益	72,968	295,330
特別利益	44,071	17,640
特別損失	251,354	1,298,503
税引前当期純損失	134,314	985,532
法人税、住民税及び事業税	366	9,508
法人税等調整額	△ 59,188	△ 355,813
当期純損失	75,493	639,227
前期繰越利益	403,976	714,514
当期末処分利益	328,483	75,287

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

利益処分 (単位:千円)

摘要	第23期	第22期
当期末処分利益	328,483	75,287
特別償却準備金取崩額	871	1,172
別途積立金取崩額	500,000	500,000
計	829,355	576,459
これを次のとおり処分いたします。		
株主配当金	137,073	172,482
次期繰越利益	692,281	403,976

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

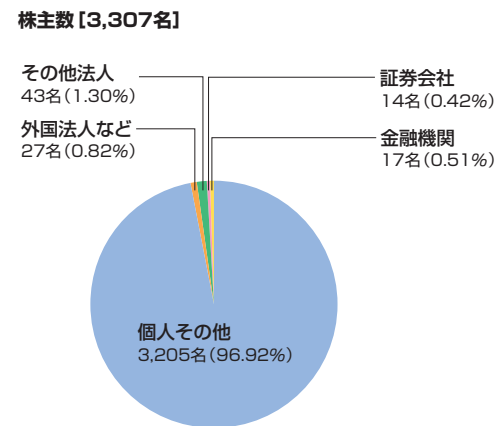
株式の概況／会社概要



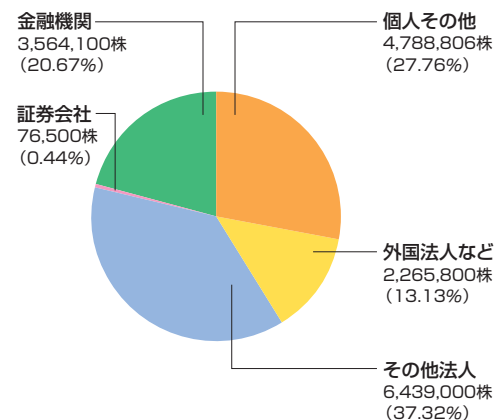
大株主 (平成15年3月31日現在)

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
1.三井物産株式会社	2,800,000	16.23
2.株式会社小松製作所	1,820,000	10.55
3.株式会社クボタ	1,200,000	6.96
4.山村 章	953,400	5.53
5.ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン	653,700	3.79
6.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	576,700	3.34
7.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	516,800	3.00
8.株式会社東京三菱銀行	420,000	2.43
9.住友信託銀行株式会社	400,000	2.32
10.エムエルビー エフエス カストディー	314,800	1.82

所有者別株式分布状況 (平成15年3月31日現在)



株式数 [17,251,325株]



(注) 自己株式117,119株は上記の円グラフ中の株主数・株式数に含まれていません。

会社概要 (平成15年6月24日現在)

商号 株式会社フェローテック
 (英文表記) Ferrotec Corporation
 設立 昭和55年9月27日
 資本金 58億2,490万円
 決算期 3月31日
 従業員数 127名
 事業所 本社
 〒104-0031東京都中央区京橋1-4-14
 千葉テクニカルセンター
 〒289-2131千葉県八日市場市みどり平1-4
 物流センター
 〒289-2131千葉県八日市場市みどり平13-5

役員 (平成15年6月24日現在)

代表取締役社長 山村 章
 取締役 賀 賢漢
 取締役 福井 徹
 取締役 神野 公行
 取締役 吉田 勝
 取締役 椿 勲
 常勤監査役 松井 宏之
 監査役 中元 紘一郎
 監査役 木下 隆博

グローバルネットワーク (平成15年6月24日現在)

- 国内
 - 株式会社フェローテック (東京)
 - 株式会社フェローテックシリコン (東京)
 - ダイヤセルテック株式会社 (東京)
 - 株式会社フェローテック精密 (岩手)
 - 株式会社フェローテックオーツ (大阪)
- 海外
 - 杭州大和熱磁電子有限公司 (中国杭州市)
 - 杭州日磁科技工業園産業開発有限公司 (中国杭州市)
 - 上海申和熱磁電子有限公司 (中国上海市)
 - Ferrotec Corporation Singapore Pte. Ltd. (シンガポール)
 - Ferrotec(USA) Corporation (アメリカ)
 - Ferrotec GmbH (ドイツ)
 - Ferrotec Ltd. (イギリス)
 - Ferrotec S.A. (スペイン)
 - Ferrotec S.R.L. (イタリア)
 - Ferrotec SARL (フランス)
 - Ferrotec Engineering SRL (ルーマニア)

